

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟向大华银行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、授信及担保情况概述

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向大华银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币6,000.00万元（含）的综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。

上述向银行申请授信额度及担保事项，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次交易目的和对公司的影响

公司实际控制人杨裕镜先生为公司向银行申请授信额度提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，未向公司收取费用，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不存在违反相关法律法规的情形。

三、审议程序与相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年11月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟向大华银行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》，会议表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，本次董事会会议中，出席会议的董事长杨裕镜先生、董事康耀伦先生、董事游仲华先生、董事何正宇先生作为关联方回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：公司实际控制人杨裕镜先生为公司向大华银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保事项，是基于公司正常生产经营的需要，且未向公司收取任何费用，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响。关联董事在审议过程中采取了回避表决的措施，公司董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于公司拟向大华银行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

（三）监事会意见

公司于2023年11月9日召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟向大华银行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》，会议表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年11月11日